

证券代码：688249

证券简称：晶合集成

公告编号：2024-047

合肥晶合集成电路股份有限公司

关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

回购方案首次披露日	2023/12/25
回购方案实施期限	2024年3月15日~2025年3月14日
预计回购金额	500,000,000元~1,000,000,000元
回购用途	<input type="checkbox"/> 减少注册资本 <input checked="" type="checkbox"/> 用于员工持股计划或股权激励 <input type="checkbox"/> 用于转换公司可转债 <input type="checkbox"/> 为维护公司价值及股东权益
累计已回购股数	54,771,427股
累计已回购股数占总股本比例	2.73%
累计已回购金额	786,662,170.25元
实际回购价格区间	12.97元/股~15.31元/股

一、 回购股份的基本情况

2023年12月22日，公司召开了第一届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司使用超募资金、自有及自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份用于股权激励。回购资金总额不低于人民币50,000万元（含），不超过人民币100,000万元（含）。回购价格不超过人民币25.26元/股（含），回购期限为自公司股东大会审议通过本次回购方案之日起12个月内。独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司于2023年12月29日、2024年3月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《晶合集成关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告（更正后）》（公告编号：2023-042）、《晶合集成关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2024-017）。

二、 回购股份的进展情况

根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，在回购期间内，公司应当在每个月的前 3 个交易日公告截至上月末的回购进展情况。现将公司股份回购进展情况公告如下：

截至 2024 年 7 月 31 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份 54,771,427 股，占公司总股本 2,006,135,157 股的比例为 2.73%，回购成交的最高价为 15.31 元/股，最低价为 12.97 元/股，支付的资金总额为人民币 786,662,170.25 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。

上述回购股份符合相关法律法规的规定及公司回购股份方案的规定。

三、 其他事项

公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

合肥晶合集成电路股份有限公司董事会

2024 年 8 月 2 日